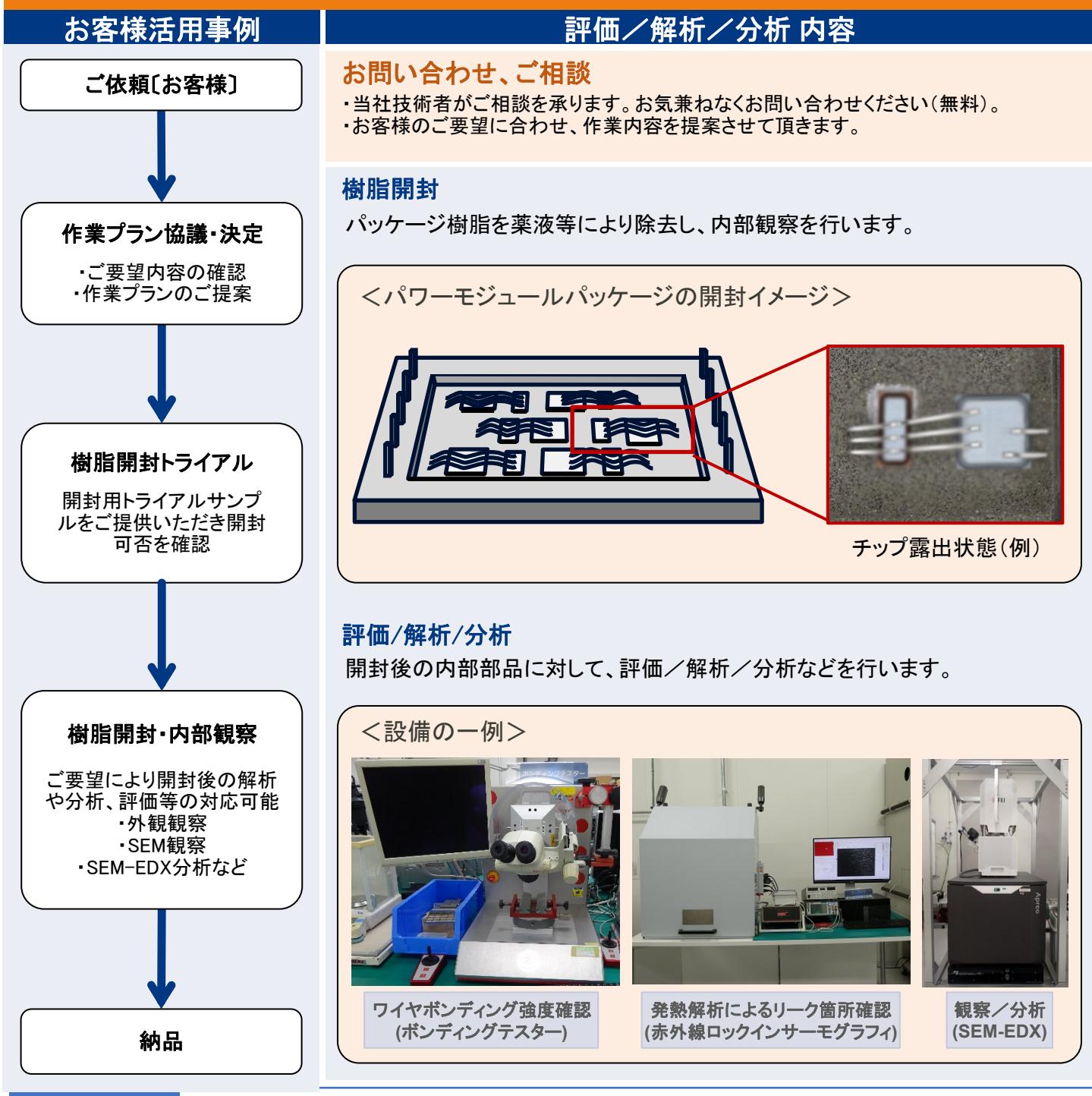


パワーモジュールの樹脂開封/解析サービス (IGBT等 高耐圧・大電流部品の樹脂開封、評価、解析、分析)

IGBT等のパワーモジュールには、パッケージ封止樹脂に充填剤が多く含まれているなど、樹脂開封が困難なものがあります。

このような“溶解困難なパッケージ樹脂の内部解析したい”というご要望にお応えします。



お問い合わせ先

ユーロフィンFQL株式会社 信頼性評価、環境試験、故障解析、品質保証サポート

<https://www.eurofins.co.jp/efql/contact>

9時～17時 土・日・祝日・当社指定の休業日を除く